

格物光学的半导体光放大器（SOA）系列产品，主要应用于PON放大、数据中心互联等光通信领域。

该系列产品采用密封的无机封装技术，保证了产品的可靠性。

产品特点

- ◆ 低噪声、高灵敏度，可满足PON上行业务放大需求
- ◆ 低功耗、高线性度，可满足数据中心互联等高速业务放大需求
- ◆ 全国产化产品，交付及时
- ◆ 定制化服务：可支持保偏、集成隔离器、集成PD光功率监控等更高集成度的器件订制

产品应用

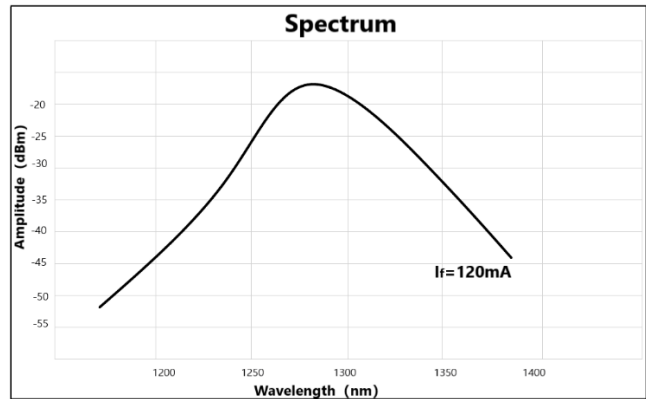
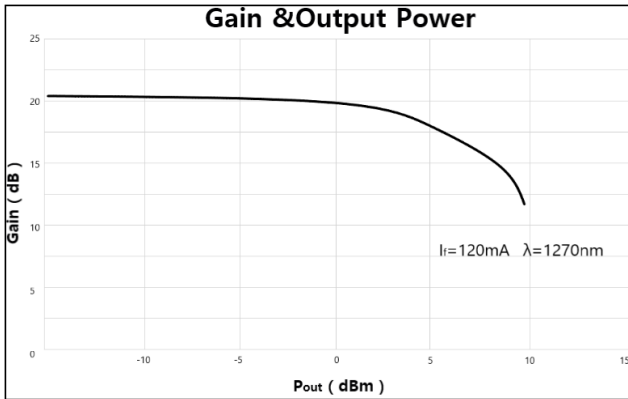
- ◆ XGPON/XGSPON/Combo PON光放大

产品规格

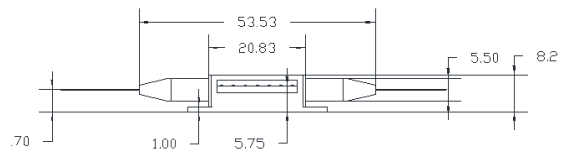
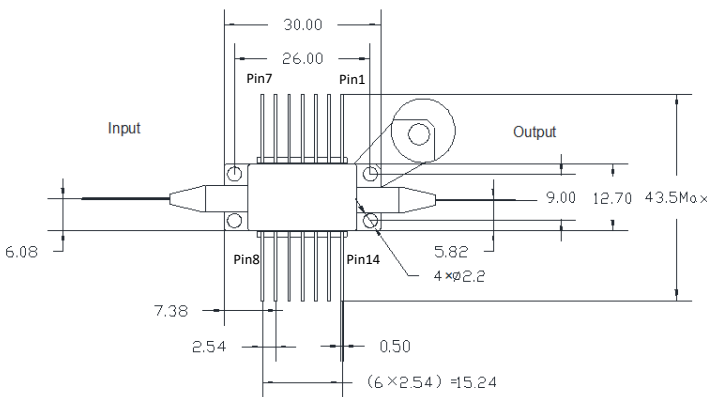
参数	符号	工作条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作波长		T=25°C	1210	1270	1330	nm
带宽	Δ	@-3dB	60	---	---	nm
小信号增益	G	If=120mA Pin=-20dBm	---	18	---	dB
饱和光功率	P_{sat}	If=120mA, Pin=0dBm	9	---	---	dBm
饱和光功率（保偏型器件）	P_{sat}	If=120mA, Pin=0dBm	7	---	---	dBm
偏振消光比（保偏器件）	Per	---	20	---	---	dB
偏振相关增益	PDG	---	---	0.3	1.0	dB
噪声系数	NF	---	---	7	8	dB
灵敏度@100G		100G LR QSFP28加 SOA误码测试		-12.5		dBm
灵敏度@10G		XGSPON 1270上行	---	-35	---	dBm
工作电流	I_f	---	---	120	250	mA
正向电压	V_f	---	---	---	1.8	V
TEC电流	I_{TEC}	---	---	---	1.8	A
TEC电压	V_{TEC}	---	---	---	3.4	V
热敏电阻阻值	R_{therm}	T=25°C	9.5	10	10.5	K
热敏电阻电流	I_{therm}	---	---	---	5	mA
气密性		T=25°C	1×10^{-12}	1×10^{-11}	1×10^{-8}	Pa.m ³ /S _o
工作温度	T_c	I=I _{op}	-10	---	70	°C
存储温度	T_{stg}	---	-40	---	85	°C

注1：气密性数值为管壳封装数值，排除管壳外部残留干扰测试得出。

典型特性



结构尺寸和管脚定义



Pin Assignments			
1	TEC (+)	14	TEC (-)
2	Thermistor	13	GND
3	NC	12	NC
4	NC	11	Chip (-)
5	Thermistor	10	Chip (+)
6	NC	9	NC
7	NC	8	NC

Note: Pin#1 is marked by a bevel (notch) at the base of the housing

订货信息

订货信息	产品描述	量产阶段
JSA-BT2710G18	1270nm-9dBm-18dB-蝶形SOA	量产
JSA-BT2710G18-PM	1270nm-7dBm-18dB-保偏蝶形SOA	样品